

Prensa Caliente Al Vacío Automática De 15 Toneladas Con Platos Calefactados De 200X200 Mm Y Enfriamiento Por Agua

Número de artículo: XP33



Introducción

Descubre la prensa caliente al vacío automática de 15 toneladas de KINTEK: platos calefactados de 200x200 mm (hasta 500 °C), control PID preciso, enfriamiento por agua y cámara de acero inoxidable SUS 304 para procesamiento en vacío o gas inerte, ideal para celdas de bolsa de baterías, laminación de polímeros y unión por difusión.

[Aprende más](#)

Aplicación	Descripción	Beneficio principal
Laminación de celdas de bolsa para baterías	La laminación de celdas de bolsa para baterías de iones de litio o de estado sólido requiere presión y calor uniformes para unir las capas sin dañar el electrolito. La capacidad de vacío elimina la humedad y los gases, evitando la delaminación y aumentando la vida útil de la celda.	Elimina la delaminación, mejora la conductividad iónica y extiende la vida útil del ciclo.
Laminación de películas poliméricas	Lamina hojas de polímero o películas compuestas para encapsulación de electrónica, empaquetado médico o pantallas flexibles en condiciones controladas de temperatura y presión.	Produce uniones sin burbujas y de alta claridad con un control preciso del grosor.
Unión por difusión	Une metales, aleaciones o cerámicas a temperaturas elevadas en alto vacío sin fusión, creando uniones por difusión atómica.	Consigue interfaces de alta resistencia sin poros, ideales para intercambiadores de calor y dispositivos microfluídicos.
Compactación y sinterización de polvos	Comprime polvos metálicos o cerámicos en un troquel bajo vacío y calor para formar gránulos o preformas densas.	Aumenta la densidad, reduce la porosidad y mejora las propiedades mecánicas y eléctricas.
Curado de materiales compuestos	Cura materiales compuestos reforzados con fibra avanzados con perfiles precisos de presión y temperatura en atmósfera inerte.	Optimiza la reticulación, evita la oxidación y garantiza laminados sin huecos.
Montaje de electrónica flexible	Lamina y encapsula circuitos flexibles, pantallas OLED o sensores de película delgada con adhesivos activados por calor en vacío.	Mantiene la alineación, elimina defectos por desgasificación y protege los componentes sensibles.

Especificación	Valor / Detalles
Modelo	XP33
Presión máxima de trabajo	≤ 15 Toneladas (150 kN)
Temperatura de trabajo del plato	Temperatura ambiente - 500 °C, pantalla táctil PID programable
Potencia de calefacción	3000 W
Dimensiones del plato	200 mm × 200 mm
Apertura del plato (Luz de apertura)	50 mm
Bomba de vacío incluida	Bomba de vacío de paletas rotativas (estándar)
Nivel de vacío (relativo)	< -0,1 MPa
Material de la cámara	Acero inoxidable SUS 304
Compatibilidad con gases atmosféricos	Nitrógeno (N ₂) / Argón (Ar)

Especificación	Valor / Detalles
Método de enfriamiento	Enfriamiento por agua circulante (ambos platos)
Dimensiones externas	650 × 492 × 725 mm
Peso neto	235 kg
Fuente de alimentación	AC 220V / 50Hz, Monofásica